

Mate2018

24th Symposium on "Microjoining and Assembly Technology in Electronics"

第24回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

～ 革新的なものづくりへの挑戦 ～

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルな最適化とそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

日 時：平成30年1月30日（火）、31日（水）

場 所：パシフィコ横浜 会議センター（横浜市西区みなとみらい1丁目1-1）

主 催：（一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
（一社）溶接学会 マイクロ接合研究委員会

共 催：（一社）エレクトロニクス実装学会、（公社）化学工学会 エレクトロニクス部会
（一社）レーザ加工学会

協 賛： 応用物理学会、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、日本機械学会、
日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会

参加申込〆切：平成30年1月12日（金）

参加申込：下記シンポジウムURLより、期日までに参加登録を行って下さい。参加費のお支払いは銀行振込にてお願い致します。なお、振込期日までにお振込みが間に合わない場合は、当日現金にてお支払い願います。

【振込先】 三井住友銀行 千里中央支店
普通口座 0978673
口座名：Mate組織委員会
[メイトソシキイインカイ]

【振込期日】平成30年2月28日（水）

【URL】 <http://sps-mste.jp/mate2018/src/>

懇親会：シンポジウム1日目に懇親会を開催します。シンポジウム参加申込時にお申し込みください。

（日 時）平成30年1月30日（火）17:40～

（場 所）パシフィコ横浜 会議センター6階

「バイブリッジカフェテリア」

（参加費）5,000円

《参加費》

主催団体個人会員	：20,000円
大学・国公立研究機関	：20,000円
口頭発表者・座長	：20,000円
主催団体維持・賛助会員	：25,000円
共催団体会員	：25,000円
協賛団体会員	：30,000円
一 般	：35,000円
学 生	：10,000円

Mate 2018 プログラム

1月30日(火)

時間	A 会場	B 会場	C 会場
8:50	開会の挨拶 Mate2018組織委員会委員長 藤本 公三 (A会場)		
9:00 ～ 10:40	<p>[A-1] パワーデバイス(1)</p> <p>1. パワー半導体のはんだ接合層における鉛直方向破壊と熱抵抗との相関調査 *福本晃久, 花田隆一郎, 横山吉典(三菱電機株)</p> <p>2. チップ下のはんだ接合部の鉛直方向破壊とはんだ厚および基板線膨張係数との関係 *花田隆一郎, 福本晃久, 小林浩(三菱電機株)</p> <p>3. ピラー状金属間化合物分散鉛フリーはんだ接合部生成に及ぼす冷却速度の影響 *三木健司, 荘司郁夫(群馬大学), 中田裕輔, 林和(株カルソニックカンセイ)</p> <p>4. ピラー状金属間化合物分散鉛フリーはんだ接合部の信頼性に関する検討 *中田裕輔, 林和, 倉澤元樹, 橋本富仁(カルソニックカンセイ株), 三木健司, 荘司郁夫(群馬大学)</p> <p>5. 低融点金属薄膜を用いた銅電極間の固液反応拡散接合-接合部欠陥の形成要因- *渡邊佑人, 福本信次, 松嶋道也, 藤本公三(大阪大学)</p>	<p>[B-1] プリントブルエレクトロニクス</p> <p>30. ストレッチャブル導電性ペースト配線の負荷-除荷過程における電気伝導特性変動 *細野雄太, 西田進一, 小山真司, 井上雅博(群馬大学)</p> <p>31. 粘接着型フィルムコネクタ用印刷配線のアンペア級電流耐性の評価 *庄子正剛, 内田智久(高エネルギー加速器研究機構), 野村健一, 堀井美徳, 牛島洋史(産業技術総合研究所)</p> <p>32. 導電性銅ナノインクの焼結と低抵抗銅厚膜形成 *川戸祐一, 有村英俊(石原ケミカル株)</p> <p>33. アディティブバタニング配線の形状安定性に及ぼすバインダ樹脂成分の影響 *李榮輔, 福本信次, 加柴良裕, 松嶋道也, 藤本公三(大阪大学)</p> <p>34. ニードル式マイクロディスペンサーを用いたナノインク描画と焼結により形成された銀電極の各種基板上での電気的特性の評価 *柏木行康, 齊藤大志, 長谷川貴洋, 千金正也(大阪産業技術研究所), 塩島謙次(福井大学), 垣内宏之(大研化学工業株)</p>	<p>[C-1] 樹脂実装</p> <p>59. 熱硬化・熱可塑性ハイブリッド樹脂を用いた自己組織化実装 *福本信次, 溝上陽介, 吉田圭佑, 上野裕輔, 松嶋道也, 藤本公三(大阪大学), 菅武(藤倉化成株), 上島稔, 水口大輔(千住金属工業株)</p> <p>60. 樹脂中のソルダぬれ性測定手法の提案とぬれ性に影響する諸因子 *溝上陽介, 福本信次, 松嶋道也, 藤本公三(大阪大学), 上島稔, 水口大輔(千住金属工業株)</p> <p>61. 半導体封止材の疲労特性に対するフィラー含有率の影響 *山口博, 榎本利章, 佐藤敏行(ナミックス株)</p> <p>62. Ag フレーク含有導電性接着剤の導電パス発達に及ぼす反応性希釈剤の添加効果 *根岸智仁, 西田進一, 小山真司, 井上雅博(群馬大学)</p> <p>63. 大気キュアした銅系導電性ペーストの湿熱環境下での導電特性変化に及ぼすフィラー表面処理剤の影響 *瓦井健太, 西田進一, 小山真司, 井上雅博(群馬大学)</p>
10:50 ～ 12:30	<p>[A-2] MEMS</p> <p>6. 【講演】MEMS-LSI 集積化とシステム実装が可能にするエッジヘビーセンシング *室山真徳(東北大学)</p> <p>7. 液体有機半導体を用いたフレキシブルマイクロ流体有機 EL リボン *登博輝, 桑江博之, 小林直史, 笠原崇史(早稲田大学), 大島寿郎(日産化学工業株), 庄子習一, 水野潤(早稲田大学)</p> <p>8. 3次元実装機を用いた 3D-MID への高集積部品実装 *山本光世(JOHNAN株), 松永忠雄(東北大学), 岡孝充, 野崎浩司(JOHNAN株), 芳賀洋一(東北大学)</p> <p>9. 非晶質層を用いた LiTaO₃/Quartz 接合 SAW 基板の作製 *須崎遥, 桑江博之(早稲田大学), 岸田和人(株日本製鋼所), 庄子習一, 水野潤(早稲田大学)</p>	<p>[B-2] 回路基板</p> <p>35. 【講演】エッチングを必要としないプリント配線基板製造工法の開発 *加藤義尚(福岡大学), 北田真也, 本田耕児, 鈴木治行(アサダメッシュ株), 加東隆(奥野製薬工業株), 山口範博, 寺田恒彦(タツタ電線株), 太田茂男, 酒井善夫, 丸澤尚(互応化学工業株)</p> <p>36. 2/2 μm 以下の絶縁信頼性に優れた微細配線層の開発 *溝倉一行, 鳥羽正也, 峯岸知典, 蔵潤和彦(日立化成株), 藤本公三(大阪大学)</p> <p>37. 薄膜キャパシタ内蔵大型パッケージ基板の信頼性 *渡邊真名武, 小出正輝, 福園健二(富士通アドバンストテクノロジー株), 水谷大輔, 赤星知幸(株富士通研究所), 藤崎秀彦, 山脇清吾, 福井慧(富士通インテグレーションテクノロジーズ株), 安達裕幸, 山田順(富士通株)</p> <p>38. シリコンオリゴマーを用いた表面処理への応用例 *佐土原大祐, 伊部公太, 松本守治, 清野正三, 西川賢一(株JCU)</p>	<p>[C-2] 生産・製品システム</p> <p>64. 電気製品事故の事故解析技術 *廣岡知之, 井原惇行, 小林吉一(楠本化成株)</p> <p>65. ロックイン赤外線発熱法を活用した新しい解析システムの構築 *高森圭, 中村典子(沖エンジニアリング株)</p> <p>66. 製品設計案の機能検証のための製品の使い方の予測に関する研究 *森永英二, 若松栄史(大阪大学), 目賀真周(大阪大学, 現 楽天株), 荒井栄司(大阪大学)</p> <p>67. 多品種生産ラインにおけるエネルギー原単位のロットサイズ依存性に関する考察 *山本将大, 日比野浩典, 堀川貴正(東京理科大学), 山口誠(秋田大学)</p> <p>68. システムモデルを用いた階層型最適化問題への自動分割と 3DLSI 概略設計への適用 寺田 謙史(大阪大学, 現パナソニック株), *岩田 剛治, 村田秀則(大阪大学), 河村 憲(大阪大学, 現ダッソー・システムズ株)</p>
12:30	昼食休憩		
13:30 ～ 15:30	<p><プレナリーセッション> ～人工知能(AI)を活用した革新的なものづくりへの挑戦～ (A会場)</p> <p>1. 最新AIの動向と社会への影響 山口 高平 (慶應義塾大学)</p> <p>2. スマートなものづくりを支えるAI技術 澁谷 利行 (株富士通研究所)</p>		
15:40 ～ 17:25	<p><ポスターセッション>、ポスタープレゼン 15:40～16:20(A会場)、パネル説明 16:25～17:25、Coffee Break(3階 フォワイエ)</p> <p>P-1. 厚膜レジストを用いたオプトジェネティクス解析のための局所光刺激機構と神経電位解析アレイの集積化 *海野陽平, 上野秀貴, 伊東貴広, 飯田泰基, 山田功(群馬大学), 駒井章治(奈良先端科学技術大学院大学), 鈴木孝明(群馬大学, JST さきかけ)</p> <p>P-2. UV ナノインプリントによる球面ミラー付きポリマー光導波路の試作 *鈴木健太, 天野建, 乗木暁博(産業技術総合研究所)</p> <p>P-3. Cu-Mg 合金から作製した Cu ナノポーラスシートを用いた接合部の高温放置試験 *古賀俊一, キムミンス(大阪大学), 齋藤美紀子, 水野潤(早稲田大学), 西川宏(大阪大学)</p> <p>P-4. 銅の超音波接合部の熱疲労特性 *伏見孝仁, 松田朋己, 佐野智一, 廣瀬明夫(大阪大学), 田中陽, 小林浩(三菱電機株)</p> <p>P-5. 誘導加熱を用いた鉛フリーはんだノブの界面金属間化合物形成とその成長 *張宇健, 何思亮, 西川宏(大阪大学)</p> <p>P-6. FPC を用いた超薄型高圧電源の開発 *指田和之(新電元工業株)</p> <p>P-7. 過酸化水素を添加剤として用いたマイクロ波液中プラズマまたは化学還元法による Ag ナノ粒子の合成 *西本大夢(北海道大学), 住友金属 鉦山株, 米澤徹(北海道大学)</p> <p>P-8. 低温焼結した樹脂結合型銀マイクロペーストの微細組織評価 *中澤史徳, 萩原順, 西田進一, 小山真司, 井上雅博(群馬大学)</p> <p>P-9. Ag ナノ粒子焼結体のクリープ変形 *久我敦, 荻谷義治(芝浦工業大学), 水村宣司, 佐々木幸司(ナミックス株)</p> <p>P-10. 3種類の異なる試験法を用いた Sn-5.0Sb 合金のクリープ変形機構解析 *大野佳祐, 荻谷義治(芝浦工業大学), 外菌洋昭(富士電機株)</p> <p>P-11. 単結晶ピスマスの[2-1-10]方向における双晶回復挙動 *坂居貴雅, 荻谷義治(芝浦工業大学), 渡邊裕彦, 外菌洋昭(富士電機株)</p> <p>P-12. エポキシ系アンダーフィル材料の疲労き裂進展速度におよぼすフィラー含有率の影響 *石橋淳, 荻谷義治(芝浦工業大学), 佐藤敏行, 榎本利章, 山口博(ナミックス株)</p> <p>P-13. 熱可塑性炭素繊維強化樹脂と炭素鋼板との垂直加振モード超音波接合 *内田裕己, 安田清和(大阪大学)</p> <p>P-14. 樹脂フィルム積層金属板への超音波樹脂溶着の評価 *一松 暁登(日本アビオニクス株)</p> <p>P-15. 実装両面基板のハンダ接合部、部品内臓基板の高速三次元構造解析技術 *北尾篤史, 小島卓磨, 夏原正仁(株島津製作所)</p> <p>P-16. 加圧焼結した Ag ナノ粒子の疲労き裂進展速度におよぼす焼結圧力の影響 *佐藤隆彦, 荻谷義治(芝浦工業大学)</p> <p>P-17. Bi 基合金の実装品質改善および高信頼性化 *立花芳恵, 上島稔(千住金属工業株)</p> <p>P-18. 減圧プロセスによる ZeroDefect ダイボンド *峯岸一博, 稲葉耕, 鶴飼竜史(千住金属工業株)</p>		
17:40	懇親会 (6階 ベイブリッジカフェテリア)		

1月31日(水)			
時間	A 会場	B 会場	C 会場
8:40 ～ 10:00	[A-3] ソルダリング(1) 10. すず中の不純物元素が機械的特性に及ぼす影響 *岩田典也, 山下浩儀, 北川惣康, 出田吾朗, 大川太(三菱電機株) 11. はんだ組成が凝固過程に及ぼす影響 *小川翔平, 藤野順司, 石川悟(三菱電機株), 石山祐介(メルコパワージェナティブ) 12. InSn合金の凝固過程に及ぼす Ag 添加の影響 *上村泰紀, 酒井泰治, 作山誠樹(群富士通研究所) 13. Sn-57Bi-1Ag 鉛フリーはんだを用いた低温接合に及ぼす Ag 電極材の影響 *丸屋優樹, 秦英恵, 荘司郁夫(群馬大学)	[B-3] ナノマテリアル・マイクロ接合(1) 39. 無加圧銀焼結接合によるヒートサイクル信頼性の向上 *渡辺智文, 田中啓啓, 中島尚耶, 武居正史(バンダー化学株) 40. 酸化銀還元反応を利用したその場生成 Ag ナノ粒子による金属-Siの接合 *伊波康大, 松田朋己, 佐野智一, 廣瀬明夫(大阪大学) 41. ナノ Ag ベースに添加した微量元素の影響と粒成長効果の違い *森田紗織, 加藤祥子, 望月昭宏, 村上佳男(マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株) 42. 無加圧焼成可能な焼結 Cu 接合材による高熱伝導, 高信頼性接合 *中子偉夫, 石川大, 須鎌千絵, 川名祐貴, 根岸征央, 江尻芳則(日立化成株)	[C-3] 熱マネジメント(1) 69. 熱流体シミュレーションによる過渡熱現象の再現 *加藤博照(産業技術総合研究所, 矢崎総業株), 村上善則(日産自動車株), 加藤史樹, 佐藤伸二, 佐藤弘, 山口浩(産業技術総合研究所) 70. プリント基板実装部の熱抵抗連続測定技術 *篠田卓也(株デンソー), 中嶋達也, 武井春樹(株IDA), 富田直人, 羅亜非, 原智章(メタテックジャパン株), 安井龍太(株メイテック), 中溝裕己(パーソナル R&D株) 71. 高温動作パワーモジュール用ベースプレート材の検討 *孝井健一(産業技術総合研究所/カルソニックカンセイ株), 加藤史樹(産業技術総合研究所), 谷沢秀和(産業技術総合研究所/サンケン電気株), 佐藤伸二(産業技術総合研究所), 村上善則(日産自動車株), 佐藤弘(産業技術総合研究所) 72. 接合材料のパワーサイクル試験による信頼性評価を目的としたパワーモジュールの検討 *八坂真一, 田口勇, 篠原俊朗(神奈川県立産業技術総合研究所)
10:10 ～ 11:30	[A-4] ソルダリング(2) 14. ギ酸雰囲気下における Sn-Ag-Cu はんだ濡れ挙動の直接観察 *何思亮, 西川宏(大阪大学) 15. レーザはんだ付した Sn-Ag-Cu-Ni はんだバンプの微細組織評価 *松延諒, 西川宏(大阪大学) 16. レーザー処理による表面微細クレバス構造における特異拡張濡れ挙動 *Jaebong YEON, 中本将嗣, 松本良, 宇都宮裕, 田中敏宏(大阪大学) 17. Sn-Ag-Cu-Ni-Ge微小試験片の引張特性および疲労特性に及ぼす温度の影響 *横井雅輝, 荘司郁夫(群馬大学)	[B-4] ナノマテリアル・マイクロ接合(2) 43. 焼結銀接合したパワー半導体の寿命予測における機械的特性値の影響 *大浦賢一, 伊勢谷健司, 安藤知明, 小池邦昭(株先端力学シミュレーション研究所) 44. 焼結 Ag 接合部の信頼性評価における期間短縮手法の開発 *田中陽, 瀧久幸, 横山古典, 林功明, 谷垣剛司, 小林浩(三菱電機株) 45. Ag ナノ粒子焼結体の疲労き裂進展速度におよぼす焼結温度の影響 *木村良, 菊谷義治(芝浦工業大学), 水村直司, 佐々木幸司(ナミックス株) 46. Kinetics of Solid-state Reactive Diffusion between Cu and Sn-Ag Alloys at 473 K *Minho O, 中山美紗子, 梶原正憲(東京工業大学)	[C-4] 熱マネジメント(2) 73. 赤外線サーモグラフィによる抵抗皮膜の熱伝導率測定法の検討 *青木洋稔, 平沢浩一, 有賀善紀, 山辺孝之(KOA株), 福江高志(岩手大学) 74. 熱流体シミュレーションとの連携による D5470 規格に準じた定常法熱伝導率測定装置の精度向上 *Wasanthamala Badalawa, Yafei Luo (メタテック・グラフィックス・ジャパン株) 75. 3次元積層 IC における局所発熱源からの放熱特性に与えるアンダーフィル層の影響 *佐々木真, 菊池遼, 酒井泰治, 作山誠樹(富士通株) 76. 定常温度予測法による絶縁性放熱シートの熱伝導率計測に与える計測部の断熱性能の影響 *浦田航平, 畠山潤平, 廣瀬宏一, 内館道正, 福江高志(岩手大学)
11:30	昼食休憩		
12:30 ～ 13:50	[A-5] パワーデバイス(2) 18. 破壊力学によるパワーモジュール用アルミワイヤ接合部の熱疲労強度評価 *諸岡航(佐賀大学), 葉山裕, 宍戸信之(北九州市環境エレクトロニクス研究所), 萩原世也(佐賀大学), 宮崎則幸(北九州市環境エレクトロニクス研究所) 19. パワーモジュールに適用するためのプレスフィット接続技術の開発 *江草稔, 須藤進吾, 大坪義貴, 益本寛之(佐賀大学), 石橋秀俊(三菱電機株), 加柴良裕(大阪大学) 20. パワーモジュールにおける Cu ワイヤを用いた高耐久接合構造の検討 *内田祥久, 柳本辰則, 佐藤祐司, 山崎啓次, 浅田晋助, 西川和康(三菱電機株) 21. パワーモジュールにおけるスイッチング波形の変化によるワイヤ接合部の劣化検知方法 *伊藤悠策, 中松佑介, 矢野新也, 森崎翔太(三菱電機株)	[B-5] 回路基板の信頼性評価 47. 有限要素解析によるガラス基板のき裂発生メカニズムの調査 *篠原亜門, 荘司郁夫(群馬大学), 梅村優樹(凸版印刷株) 48. 樹脂の硬化収縮を考慮した回路基板の反り予測技術 *長岡秀明, 赤星知幸, 水谷大輔, 作山誠樹(群富士通研究所), 長竹真美(富士通アドバンステクノロジ株), 伊東伸孝(株テクノロジ・ラボ) 49. プリント配線板の加温試験における温・湿度ストレスの影響 *市川克之, 井原惇行, 小林吉一(楠化成株) 50. 構造因子とラフネスを考慮した高密度配線板用スルーホールめっき膜の熱疲労寿命予測 *渡邊和貴, 荻谷義治(芝浦工業大学), 広島義之, 菊池俊一, 松井亜紀子(富士通アドバンステクノロジ株), 清水浩(日立化成株)	[C-5] 実装構造 77. 3次元実装におけるはんだ接合構造の許容電流密度に及ぼす影響 *山崎一寿, 北田秀樹, 赤松俊也, 作山誠樹(富士通株) 78. はんだ充填ガラス貫通ビア構造の評価 *青木豊広, 小原さゆり, 中村英司, 久田隆史, 末岡伸昭, 堀部晃啓, 森裕幸(日本アイ・ビー・エム株) 79. 高生産性 3D スタックプロセス *本田一尊, 柳田裕貴, 上野恵子(日立化成株) 80. UV-LED 向け高出力・高気密パッケージ技術の開発 *植田充彦, 美濃卓哉, 明田孝典, 椿健治(パナソニック株)
13:50	Coffee Break		
14:10 ～ 15:30	[A-6] パワーデバイス(3) 22. 無電解 Ni-P/置換 Cuめっきが 200 °C高温環境下のはんだ接合信頼性に及ぼす影響 *大矢怜史, 中木原早紀, 芳片敏之, 新子比呂志(株クオルテック) 23. はんだの耐熱疲労性を予測する手法の提案 *村松佑哉, 別芝範之, 林功明, 山本和幸(三菱電機株) 24. 高温高湿試験による銅/エポキシ樹脂接着界面の寿命評価 *戸野塚悠, 荘司郁夫(群馬大学), 外園洋昭(富士電機株), 高橋邦明(株産業分析センター), 江連徳(エスベック株) 25. 3点曲げ試験による溶ダ接合部の熱サイクル疲労寿命予測における応力勾配の影響 *遠藤慶, 松嶋道也, 福本信次(大阪大学), 外園洋昭(富士電機株), 藤本公三(大阪大学)	[B-6] 接続信頼性評価 51. ワイヤボンディングにおける超音波振動の加振力と接合品質に関する研究 *鈴木淳也, 山本和幸, 堀田学(三菱電機株) 52. BGA 接合部のき裂発生および進展予測シミュレーションの精度検証 *福園健治, 小出正輝, 渡邊真名武(富士通アドバンステクノロジ株) 53. ソルダペーストを利用した表面実装でのボイド形成機構の検討 *李建永, 高橋政典, 長谷川将司, 佐藤豪祐, 新子比呂志(株クオルテック) 54. 低温はんだ実装品における Sn ウィスカの発生 *斎藤彰彰(株村田製作所), 西川宏(大阪大学)	[C-6] マイクロ加工 81. MacEtch 法を用いた Si の微細加工技術開発 *佐野光雄, 松尾圭一郎, 小幡進, 福満昌子, 樋口和人, 下川一生, 佐藤隆(株東芝) 82. 超音波照射下における鉛フリーはんだ微粒子の加工 *古澤彰男, 日根清裕(パナソニック株), 林大和, 滝澤博胤(東北大学) 83. フィルムモールドを用いた量産対応ナノインプリントプロセスの開発 *後藤博史, 小久保光典(東芝機械株) 84. 超短パルスレーザによるガラス着色技術の開発 和田紀彦, 葛西孝昭, 北村嘉朗, 森重之, *藤原和樹(パナソニック株)
15:40 ～ 17:00	[A-7] パワーデバイス(4) 26. All-SiC モジュールの高耐圧化 *平尾章, 日向裕一郎, 堀元人, 谷口克己, 池田良成(富士電機株) 27. パワーモジュールにおける熱サイクル試験時の封止樹脂のはく離予測評価 *池田徹(鹿児島大学), 川下隼介, 七藏司優斗, 小金丸正明, 外園洋昭, 浅井竜彦(富士電機株) 28. パワーモジュール向け高放熱接着シートの開発 *山田岳史, 大津猛, 藤井飛鳥, 福田芳弘, 柏崎史, 森貴裕(株ADEKA) 29. 高耐熱性封止材のフィルム化技術 *柄澤泰紀, 根津裕介, 菊池和浩, 杉野貴志(リンテック株)	[B-7] 新材料・プロセス 55. 有限要素法による多孔質材料の大変形シミュレーション *諸隈湧気(群馬大学), 鎌腰雄一郎(群馬大学, 群馬産業技術センター), 西田進一, 荘司郁夫(群馬大学) 56. くし状構造の積層による側面接触型弾性梁集合体の試作 *サリュコフ ミハイル, 高橋邦夫, 齋藤滋規, ヘムタビー・パソムポーン, 井口洋二(東京工業大学) 57. 生体材料の高解像度 TEM 観察に向け、ダイヤモンド薄膜を用いた新規 TEM グリッド *徐秉陽, 桑江博之, 水野潤, 庄子習一(早稲田大学) 58. Al/Ni 系材料の瞬間発熱反応を熱源に用いたはんだ接合技術の研究 *和泉大門, 永田将, 三宅修吾(神戸市立工業高等専門学校), 金築俊介(株コペルコ科研), 生津資大(愛知工業大学)	
17:00 ～ 17:20	表彰式 (A会場) 閉会の挨拶 Mate2018組織委員会副委員長 青柳 昌宏 (A会場)		

※ 掲載内容は、当日変更される場合があります。

組織委員会

委員長	： 藤本公三 (大阪大学)		
副委員長	： 青柳昌宏 ((国研)産業技術総合研究所)	廣瀬明夫 (大阪大学)	
委員	： 瀧美幸一郎 (大阪大学)	荒井栄司 (大阪大学)	小勝俊巨 (日本電気(株))
	河崎貴文 (三菱電機(株))	川田辰実 (富士電機(株))	小林紘二郎 ((一財)電子科学研究所)
	齋藤重正 ((同)フロンティア・アライアンス)	佐藤武彦 (大阪大学)	佐藤了平 (大阪大学)
	嶋田勇三 (ナミックス(株))	菅沼克昭 (大阪大学)	清野武寿 ((株)東芝)
	高橋康夫 (大阪大学)	竹本 正 (大阪大学)	田中敏宏 (大阪大学)
	寺前俊哉 ((株)日立製作所)	西田一人 (パナソニック(株))	貴井 孝 (大阪大学)
	益子原學 ((株)サイキューブ)	松村慶一 (インフィテックエム(株))	南二三吉 (大阪大学)
	南尾匠紀 (パナソニック(株))	宮崎則幸 (北九州市環境山外工務研究所)	森 郁夫 (ファナック(株))
	矢野 映 ((株)富士通研究所)	山本治彦 (富士通ICT(株))	

実行委員会

委員長	： 加柴良裕 (大阪大学)		
副委員長	： 作山誠樹 ((株)富士通研究所)	福本信次 (大阪大学)	森 三樹 (東京大学)
委員	： 青島正貴 (トヨタ自動車(株))	朝倉義裕 (神戸市立工業高等専門学校)	新井 進 (信州大学)
	安藤哲也 (室蘭工業大学)	池田 徹 (鹿児島大学)	石橋正朗 (凸版印刷(株))
	出田吾朗 (三菱電機(株))	市村裕司 (富士電機(株))	一山靖友 (日鉄住金テクノロジ-(株))
	井上雅博 (群馬大学)	岩田剛治 (大阪大学)	于 強 (横浜国立大学)
	上西啓介 (大阪大学)	上村泰紀 ((株)富士通研究所)	海老原伸明 (NECパナソニック(株))
	大口達也 (日本アビオニクス(株))	大熊秀雄 ((有)エイチ・ティー・オー)	大村悦二 (大阪大学)
	小椋 智 (大阪大学)	折井靖光 (長瀬産業(株))	梶原隆志 (エスベック(株))
	鎌田信雄 (化研テック(株))	苅谷義治 (芝浦工業大学)	木村裕二 ((株)村田製作所)
	久保雅男 (パナソニック(株))	高齋光弘 (千住金属工業(株))	河野英一 ((株)河野エムイー研究所)
	小山真司 (群馬大学)	阪元智朗 (オムロン(株))	佐藤 強 ((株)東芝)
	佐名川佳治 (パナソニック(株))	佐野智一 (大阪大学)	柴崎正訓 ((株)タムラ製作所)
	澁谷忠弘 (横浜国立大学)	荘司郁夫 (群馬大学)	芹沢弘二 (千住金属工業(株))
	高尾尚史 ((株)豊田中央研究所)	高岡英清 ((株)村田製作所)	高橋 邦夫 (東京工業大学)
	武井利泰 ((株)ジャパンユニックス)	津久井勲 (リサーチラボ・ツクイ)	富岡泰造 ((株)東芝)
	富村壽夫 (熊本大学)	中田裕輔 (カルソニックカンセイ(株))	西浦正孝 (パナソニック(株))
	西川 宏 (大阪大学)	久田隆史 (日本アイ・ピー・エム(株))	松岡 洋 (日本電気(株))
	松坂壮太 (千葉大学)	松嶋道也 (大阪大学)	松林 良 (新電元工業(株))
	圓尾弘樹 (パナソニックファクトリーソリューションズ(株))	水野 潤 (早稲田大学)	満倉一行 (日立化成(株))
	村井淳一 (三菱電機(株))	村山 啓 (新光電気工業(株))	森 貴裕 ((株)ADEKA)
	森永英二 (大阪大学)	安田清和 (大阪大学)	山内 啓 (群馬工業高等専門学校)
	山口敦史 (パナソニック(株))	山田博之 ((株)デンソー)	山中公博 (中京大学)
	山根常幸 ((株)東レリサーチセンター)	山部光治 ((株)東芝)	山本哲也 ((株)東芝)
	横沢伊裕 (宇部興産(株))	和田剛優 ((株)弘輝)	渡邊 聡 (藤倉化成(株))
	渡辺 潤 (長野野電気(株))	渡邊裕彦 (富士電機(株))	

(依頼中を含む)

会場アクセス

パシフィコ横浜 会議センター

- * みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩3分
- * JR線・市営地下鉄 桜木町駅より徒歩12分
- * 横浜駅よりタクシー7分、シーバス(船)で10分



問合わせ先：Mate 2018 事務局

(TEL) 06-6878-5628, (FAX) 06-6879-7568

(E-mail) mate@sps-mste.jp, (URL) <http://sps-mste.jp/mate2018/src/>